

证券代码：002156 证券简称：通富微电

通富微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	东北证券：黄磊；国信证券：胡剑
时间	2025 年 6 月 25 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 蒋澍
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司概况 通富微电是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供设计仿真和封装测试一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位涵盖人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等领域。公司大股东为南通华达微电子集团股份有限公司，实际控制人为石明达先生，股权结构稳定。 公司先后在江苏南通崇川、南通苏通科技产业园、安徽合肥、福建厦门、南通市北高新区建厂布局；通过收购 AMD 苏州及 AMD 槟城各 85%股权，在江苏苏州、马来西亚槟城拥有生产基地。2024 年，公司与相关方签订《股权买卖协议》，以自有资金收购京隆科技 26%股权，京隆科技运营模式和财务状况良好，其在高端集成电路专业测试领域具备差异化竞争优势。公司已于 2025 年 2 月 13 日完成交割并支付了相关股权购买价款，公司收购京隆科技部分股权可提高公司投资收益，为公司带来稳定的财务回报，为全体股东创造更多价值。 目前，公司在南通拥有 3 个生产基地，同时，在苏州、槟城、合肥、厦门也积极进行了生产布局，产能方面已形成多点开花的局面，有利于公司就近更好地服务客户，争取更多地方资源。同

时，先进封装产能的大幅提升，为公司带来更为明显的规模优势。

财务数据方面，公司 2021 年、2022 年和 2023 年和 2024 年分别实现营收 158.12 亿元、214.29 亿元、222.69 亿元和 238.82 亿元。公司 2021 年、2022 年和 2023 年和 2024 年的归母净利润分别为 9.57 亿元、5.02 亿元、1.69 亿元和 6.78 亿元。

二、行业情况

2024 年，半导体行业逐步进入周期上行阶段，在全球经济逐步复苏与数字化转型加速的大背景下，半导体作为现代科技的核心基石，迎来了增长与变革，半导体行业在消费电子复苏和人工智能的创新共振中，逐步向好。消费电子领域的回暖，使得智能手机、平板电脑等设备的出货量逐步回升，拉动半导体市场规模扩张。而人工智能领域对算力的渴求，进一步拓宽了半导体行业的发展边界，为其持续增长注入源源不断的动力。

根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的统计，2024 年全球半导体销售额达到 6,276 亿美元，相较于 2023 年的 5,268 亿美元，增长 19.1%，年销售额首次突破 6,000 亿美元大关。

2024 年，全球半导体封测行业在经历了前几年的供应链波动后，逐步进入稳定增长阶段。随着人工智能、高性能计算、5G 通信、汽车电子等领域的需求驱动，封测行业作为半导体产业链的关键环节，市场规模持续扩大。根据 Gartner 于 2024 年 12 月发布的报告，2024 年全球集成电路封测市场规模预计达到 820 亿美元，同比增长 7.8%。

IDC 预计，2025 年全球半导体市场将呈现以下八大趋势：1、AI 驱动的高速增长态势仍将延续；2、亚太地区 IC 设计市场行情升温，2025 年有望再增长 15%；3、台积电将继续在晶圆代工领域占据主导地位；4、先进制程需求强劲，晶圆代工厂加速扩产；5、成熟制程市场行情回温，产能利用率将超 75%；6、2025 年为 2 纳米晶圆制造技术的关键之年；7、封测产业生态重塑，中国大陆市场份额将持续扩大，中国台湾地区 AI 封测优势提升；8、先进封装方面，扇出型面板级封装（FOPLP）深入布局，CoWoS 产能倍增。

三、2024 年及 2025 年第一季度业绩情况

2024 年，公司实现营业收入 238.82 亿元，同比增长 7.24%；公司实现归属于母公司股东的净利润 6.78 亿元，同比增长

299.90%。2025 年第一季度，公司实现营业收入 60.92 亿元，同比增长 15.34%；公司实现归属于母公司股东的净利润 1.01 亿元，同比增长 2.94%。其他 2024 年度及 2025 年第一季度详细情况，可以关注公司对外披露的公告。

四、投资者关注的主要问题

问题 1：简单介绍一下公司的业务情况及应用领域？

回复：公司是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供设计仿真和封装测试一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位涵盖人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等领域。公司紧紧抓住市场发展机遇，面向未来高附加值产品以及市场热点方向，立足长远，大力开发扇出型、圆片级、倒装焊等封装技术并扩充其产能；此外，积极布局 Chiplet、2D+等顶尖封装技术，形成了差异化竞争优势。

问题 2：公司封装技术优势是什么？

回复：公司建有国家认定企业技术中心、国家级博士后科研工作站、江苏省企业院士工作站、省集成电路先进封装测试重点实验室、省级技术中心和工程技术研究中心等高层次创新平台，拥有一支专业的研发队伍，先后与中科院微电子所、中科院微系统所、清华大学、北京大学、华中科技大学等知名科研院所和高校建立了紧密的合作关系，并聘请多位专家共同参与新品新技术的开发工作。

作为国家高新技术企业，公司先后承担了多项国家级技术改造、科技攻关项目，并取得了丰硕的技术创新成果：大尺寸多芯片 Chiplet 封装取得重要优化进展，通过改进封装结构设计和材料工艺，成功提升了封装密度、散热性能和整体可靠性；FCCSP SOC 电容背贴产品通过考核并进入量产等。

问题 3：2024 年公司在哪些领域实现了业务增长？

回复：2024 年，半导体行业逐步进入周期上行阶段，公司抓住通讯终端复苏机遇，在 SOC、WIFI、PMIC、显示驱动等核心领域均取得增长。公司紧紧抓住手机产品国产国造机遇，成为重要客户的战略合作伙伴，实现了中高端手机 SOC46%的增长，同时夯实与手机终端 SOC 客户合作基础，份额不断提升，实现了 20%的增长；在射频领域，公司与龙头客户全面合作，实现了 70%的增

	长；在手机周边领域，全面提升了与国内模拟头部超 5 家客户的合作，实现了近 40%的增长。公司精准把握市场趋势，在蓝牙、MiniLed、电视、显示驱动等消费电子热点领域取得 30%以上增长，展现多元化增长动能。公司依托工控与车规产品的技术优势，成为车载本土化封测主力，全面拓展车载功率器件、MCU 与智能座舱等产品，发挥品牌优势，扩大与海内外头部企业的合作，车载产品业绩同比激增超 200%。 问题 4：公司在与 AMD 建立的战略合作中，是否有计划扩大与 AMD 的合作，以进一步提升在先进封装领域的市场份额？ 回复：2024 年，公司与国际大客户的合作关系愈发紧密，凭借多年来与国际大客户等行业领军企业携手合作所积累的深厚经验，公司在通富超威槟城成功布局先进封装业务，建设 Bumping、EFB 等生产线。此举精准契合国际大客户的经营战略，有效助力公司在先进封装领域进一步提升市场份额。 问题 5：公司目前一些重大工程建设情况如何？ 回复：公司持续稳步推进重大项目的建设实施，确保满足当前及未来的生产运营需求，不断增强企业发展的内生动力和可持续性。 问题 6：公司 2025 年资本开支准备用于哪些方面？ 回复：公司及下属控制企业南通通富、合肥通富、通富通科、通富超威苏州及通富超威槟城等计划 2025 年在设施建设、生产设备、IT、技术研发等方面投资共计 60 亿元。其中： 崇川工厂、南通通富、合肥通富、通富通科等计划共计投资 25.00 亿元，主要用于新厂房建设，新能源、电源管理、高性能计算、智能终端、汽车电子、服务器、安防监控、显示驱动、存储、MCU 等产品的量产与研发。 通富超威苏州、通富超威槟城等计划共计投资 35.00 亿元，主要用于现有产品扩产升级，以满足大尺寸多芯片的服务器及 AI PC 等产品的量产与研发。
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 6 月 25 日